



IEC 62047-20

Edition 1.0 2014-06

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices –
Part 20: Gyroscopes**

**Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs microélectromécaniques –
Partie 20: Gyroscopes**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX XA

ICS 31.080.99

ISBN 978-2-8322-1667-5

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	6
4 Essential ratings and characteristics	6
4.1 Categorization of gyro	6
4.2 Absolute maximum ratings	7
4.3 Normal operating rating	8
4.4 Characteristics	8
5 Measuring methods	10
5.1 Scale factor	10
5.1.1 Purpose	10
5.1.2 Measuring circuit (circuit diagram)	10
5.1.3 Measuring principle	12
5.1.4 Measurement procedures	21
5.1.5 Specified conditions	23
5.2 Cross axis sensitivity	24
5.2.1 Purpose	24
5.2.2 Measuring circuit (circuit diagram)	24
5.2.3 Principle of measurement	25
5.2.4 Precautions to be observed during the measurements of the angular rate applied	27
5.2.5 Measurement procedures	27
5.2.6 Specified conditions	27
5.3 Bias	28
5.3.1 Purpose	28
5.3.2 Measuring circuit	28
5.3.3 Principle of measurement	30
5.3.4 Measurement procedures	35
5.3.5 Specified conditions	37
5.4 Output noise	38
5.4.1 Purpose	38
5.4.2 Measuring circuit	38
5.4.3 Principle of measurement	39
5.4.4 Precautions during measurement	40
5.4.5 Measurement procedures	40
5.4.6 Specified conditions	43
5.5 Frequency band	43
5.5.1 Purpose	43
5.5.2 Measuring circuit	43
5.5.3 Principle of measurement	45
5.5.4 Precautions during measurement	47
5.5.5 Measurement procedure	47
5.5.6 Specified conditions	49
5.6 Resolution	49
5.6.1 Purpose	49

5.6.2	Measuring circuit	49
5.6.3	Principle of measurement	49
5.6.4	Measurement procedures	50
5.6.5	Specified conditions.....	51
Annex A (informative)	Accuracy of measured value of gyro characteristics	52
A.1	General.....	52
A.2	Angle and angular rate.....	52
A.3	Example of angular deviation occurring after calibration.....	52
Bibliography.....		53
Figure 1 – Example of measuring circuit	11	
Figure 2 – Example of wiring configuration.....	12	
Figure 3 – Example of measurement data when the angular rate is applied	13	
Figure 4 – Example of scale factor data at each temperature	15	
Figure 5 – Example of relationship between scale factor and scale factor temperature coefficient at each temperature	16	
Figure 6 – Example of measurement of ratiometric error for the scale factor	17	
Figure 7 – Example measurement of scale factor stability	19	
Figure 8 – Example of measurement of scale factor symmetry	20	
Figure 9 – Measuring circuit for cross axis sensitivity.....	25	
Figure 10 – Principle of measurement for cross axis sensitivity.....	26	
Figure 11 – Measuring circuit 1 for bias	29	
Figure 12 – Measuring circuit 2 for bias	30	
Figure 13 – Example measurement of ratiometric error for bias	32	
Figure 14 – Bias temperature sensitivity and bias hysteresis.....	34	
Figure 15 – Bias linear acceleration sensitivity.....	35	
Figure 16 – Output noise measuring system	39	
Figure 17 – Example of wiring configuration for output noise.....	39	
Figure 18 – Frequency power spectrums.....	40	
Figure 19 – Angular random walk.....	41	
Figure 20 – Bias instability and Allan variance curve.....	42	
Figure 21 – Measuring circuit for frequency response	44	
Figure 22 – Example of wiring configuration for frequency response	45	
Figure 23 – Frequency response characteristics	46	
Figure 24 – Gain peak response characteristics.....	46	
Figure 25 – Calibration of frequency response	48	
Table 1 – Categories of gyro	7	
Table 2 – Absolute maximum ratings	7	
Table 3 – Normal operating ratings	8	
Table 4 – Characteristics	9	
Table 5 – Specified condition for measurement of scale factor	23	
Table 6 – Specified conditions for the measurement of bias	37	
Table 7 – Specified condition for the measurement of frequency band	49	
Table 8 – Specified condition for the measurement of resolution.....	51	

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES – MICRO-ELECTROMECHANICAL DEVICES –

Part 20: Gyroscopes

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62047-20 has been prepared by subcommittee 47F: Micro-electromechanical systems, of IEC 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47F/188/FDIS	47F/191/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62047 series, published under the general title *Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

**SEMICONDUCTOR DEVICES –
MICRO-ELECTROMECHANICAL DEVICES –**

Part 20: Gyroscopes

1 Scope

This part of IEC 62047 specifies terms and definitions, ratings and characteristics, and measuring methods of gyroscopes.

Gyroscopes are primarily used for consumer, general industries and aerospace applications. MEMS and semiconductor lasers are widely used for device technology of gyroscopes.

Hereafter, gyroscope is referred to as gyro.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

None

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	56
1 Domaine d'application	58
2 Références normatives	58
3 Termes et définitions	58
4 Valeurs assignées et caractéristiques essentielles	59
4.1 Catégorisation du gyro	59
4.2 Valeurs assignées maximales absolues	59
4.3 Valeurs assignées de fonctionnement normal	60
4.4 Caractéristiques	61
5 Méthodes de mesure	63
5.1 Coefficient de conversion	63
5.1.1 Objectif	63
5.1.2 Circuit de mesure (schéma du circuit)	63
5.1.3 Principe de mesure	65
5.1.4 Modes opératoires de mesure	74
5.1.5 Conditions spécifiées	76
5.2 Sensibilité de l'axe transversal	77
5.2.1 Objectif	77
5.2.2 Circuit de mesure (schéma du circuit)	77
5.2.3 Principe de mesure	78
5.2.4 Précautions à observer pendant les mesures de la vitesse angulaire appliquée	80
5.2.5 Modes opératoires de mesure	80
5.2.6 Conditions spécifiées	81
5.3 Biais	81
5.3.1 Objectif	81
5.3.2 Circuit de mesure	81
5.3.3 Principe de mesure	83
5.3.4 Modes opératoires de mesure	88
5.3.5 Conditions spécifiées	90
5.4 Bruit de sortie	91
5.4.1 Objectif	91
5.4.2 Circuit de mesure	91
5.4.3 Principe de mesure	93
5.4.4 Précautions pendant la mesure	93
5.4.5 Modes opératoires de mesure	94
5.4.6 Conditions spécifiées	97
5.5 Bande de fréquences	97
5.5.1 Objet	97
5.5.2 Circuit de mesure	97
5.5.3 Principe de mesure	99
5.5.4 Précautions pendant la mesure	101
5.5.5 Mode opératoire de mesure	101
5.5.6 Conditions spécifiées	103
5.6 Résolution	103
5.6.1 Objectif	103
5.6.2 Circuit de mesure	103

5.6.3	Principe de mesure.....	103
5.6.4	Modes opératoires de mesure.....	104
5.6.5	Conditions spécifiées.....	105
Annexe A (informative)	Exactitude de la valeur mesurée des caractéristiques du gyro	106
A.1	Généralités	106
A.2	Angle et vitesse angulaire.....	106
A.3	Exemple d'écart angulaire se produisant après l'étalonnage	106
Bibliographie.....		108
Figure 1 – Exemple de circuit de mesure	64	
Figure 2 – Exemple de configuration de câblage	65	
Figure 3 – Exemple de données de mesure lorsque la vitesse angulaire est appliquée	66	
Figure 4 – Exemple de données de coefficient de conversion à chaque température	68	
Figure 5 – Exemple de relation entre le coefficient de conversion et le coefficient de température du coefficient de conversion à chaque température	69	
Figure 6 – Exemple de mesure d'erreur ratiométrique du coefficient de conversion	70	
Figure 7 – Exemple de mesure de stabilité du coefficient de conversion	72	
Figure 8 – Exemple de mesure de symétrie du coefficient de conversion	73	
Figure 9 – Circuit de mesure de la sensibilité de l'axe transversal.....	78	
Figure 10 – Principe de la mesure de sensibilité de l'axe transversal	79	
Figure 11 – Circuit de mesure 1 du biais	82	
Figure 12 – Circuit de mesure 2 du biais	83	
Figure 13 – Exemple de mesure d'erreur ratiométrique de biais	85	
Figure 14 – Sensibilité en température du biais et hystérésis du biais	87	
Figure 15 – Sensibilité à l'accélération linéaire du biais	88	
Figure 16 – Système de mesure du bruit de sortie	92	
Figure 17 – Exemple de configuration de câblage pour le bruit de sortie	93	
Figure 18 – Spectres de puissance-fréquence	94	
Figure 19 – Marche aléatoire angulaire	95	
Figure 20 – Instabilité de biais et courbe de variance d'Allan	96	
Figure 21 – Circuit de mesure de la réponse en fréquence.....	98	
Figure 22 – Exemple de configuration de câblage pour la réponse en fréquence	99	
Figure 23 – Caractéristiques de réponse en fréquence	100	
Figure 24 – Caractéristiques de réponse de crête de gain.....	100	
Figure 25 – Étalonnage de la réponse en fréquence	102	
Tableau 1 – Catégories de gyro	59	
Tableau 2 – Valeurs assignées maximales absolues.....	59	
Tableau 3 – Valeurs assignées de fonctionnement normal	61	
Tableau 4 – Caractéristiques	62	
Tableau 5 – Condition spécifiée pour la mesure du coefficient de conversion	76	
Tableau 6 – Conditions spécifiées pour la mesure du biais	91	
Tableau 7 – Condition spécifiée pour la mesure de la bande de fréquences.....	103	
Tableau 8 – Condition spécifiée pour la mesure de résolution.....	105	

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – DISPOSITIFS MICROÉLECTROMÉCANIQUES –

Partie 20: Gyroscopes

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62047-20 a été établie par le sous-comité 47F: Systèmes microélectromécaniques, du comité d'études 47 de l'IEC: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47F/188/FDIS	47F/191/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62047, publiées sous le titre général *Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs microélectromécaniques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – DISPOSITIFS MICROÉLECTROMÉCANIQUES –

Partie 20: Gyroscopes

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62047 spécifie les termes et définitions, les valeurs assignées et les caractéristiques, ainsi que les méthodes de mesure des gyroscopes.

Les gyroscopes sont principalement utilisés dans des applications grand public, des applications industrielles générales et des applications aérospatiales. Les dispositifs microélectromécaniques (MEMS, *Micro-Electrical-Mechanical Systems*) et les lasers à semiconducteur sont largement utilisés dans la technologie des dispositifs de gyroscopes.

Un gyroscope est appelé ci-après gyro.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

Aucune